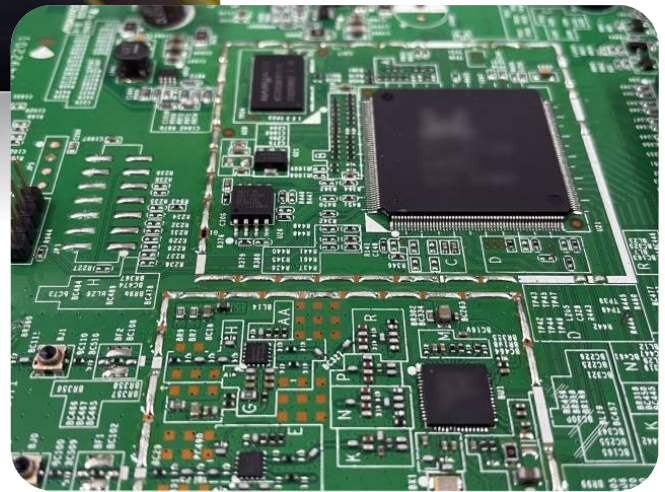
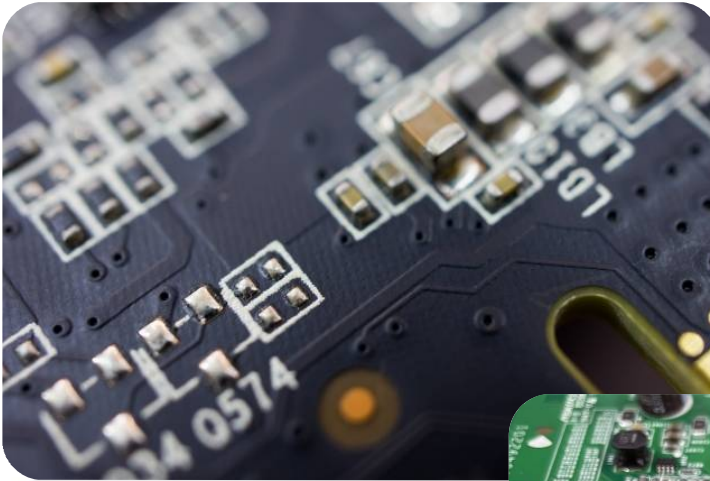


# ◆ 電子基板の断面分析 ◆

## ● はんだ付け箇所の不具合確認方法紹介 ●

電子基板への電子部品固定に『はんだ』（スズ(Sn)と鉛(Pb)を主成分とした合金）が一般的に用いられます。

電子部品を固定した基板は、はんだ付けの条件に不備が生じた場合、通電不良やショート等の機器不具合の原因として「はんだ付け箇所」に【空隙(ボイド)】や【割れ(クラック)】が発生しているケースがあります。



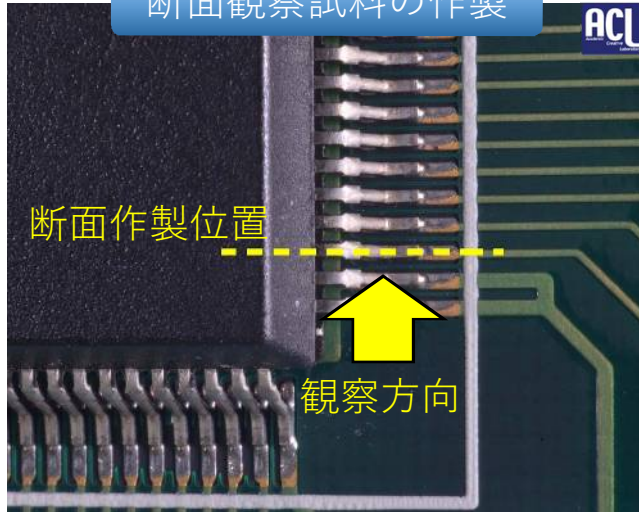
弊社では、電子基板のはんだ付け箇所の断面観察試料を作製し観察することにより、はんだの接地状況、はんだ付け箇所内部の元素分布(面分析によるはんだ構成元素の偏析)の情報から、**正しくはんだ付けされているか視覚的に確認し、貴社が評価するためのデータを提供することが出来ます。**

観察、面分析結果は裏面へ 

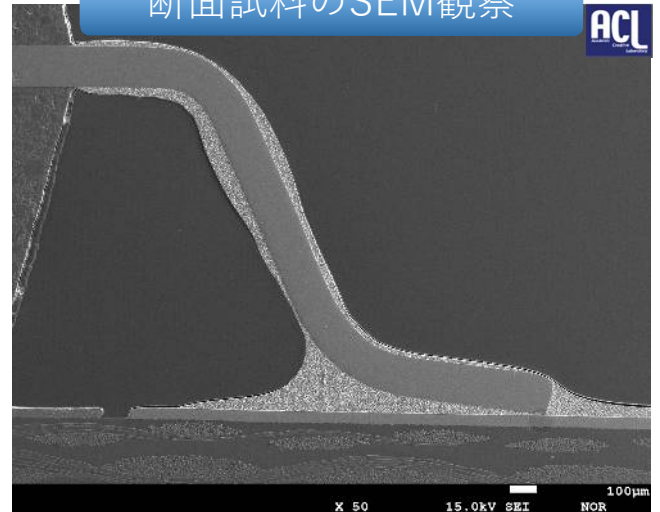
# 電子基板の断面分析

● ● はんだ付け箇所の不具合確認方法紹介 ● ●

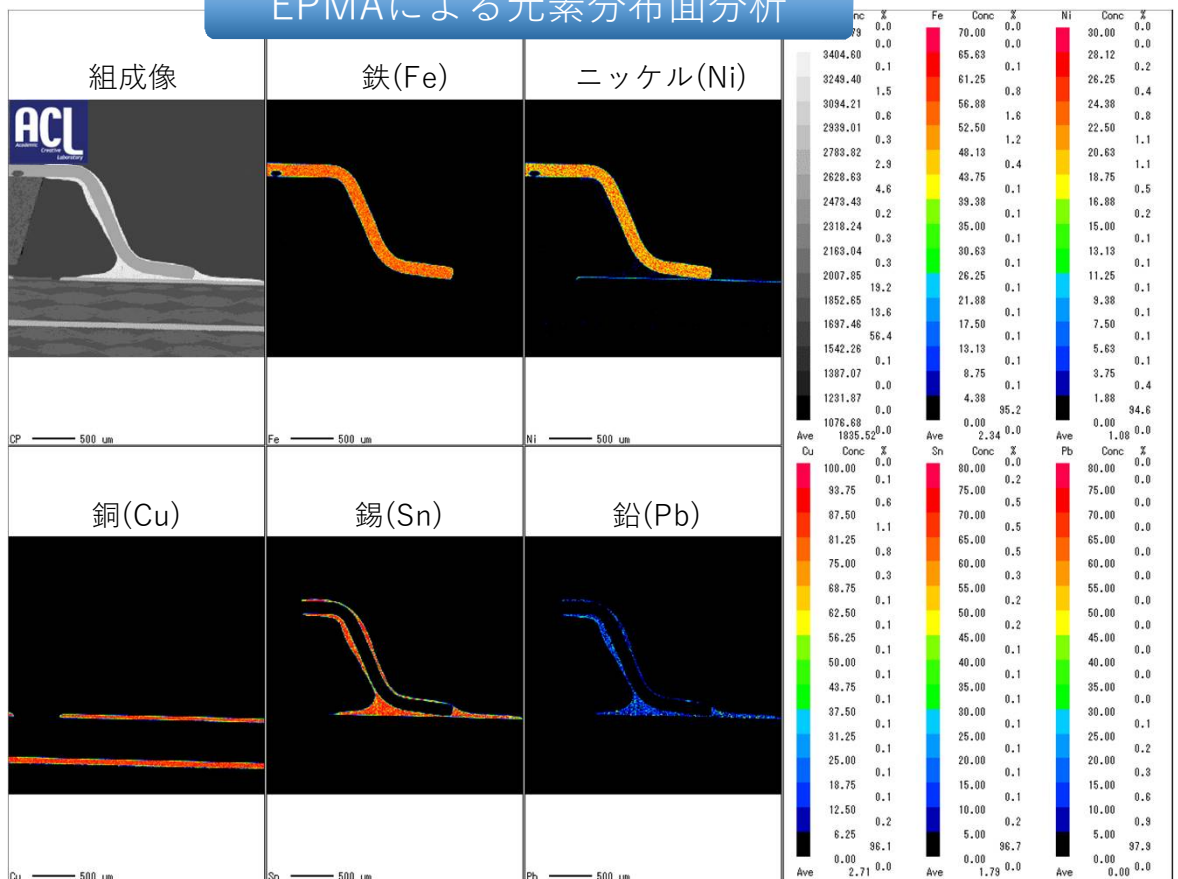
断面観察試料の作製



断面試料のSEM観察



EPMAによる元素分布面分析



以上より、はんだ付け部にクラックが無いこと、はんだ内部にボイド等の欠陥や元素の偏析が無いことが把握でき、正しくはんだ付けされていることが確認されました。

お問い合わせ先  
株式会社 分析センター URL <https://www.analysis.co.jp/>  
材料評価事業部 〒131-0032 東京都墨田区東向島1丁目12番2号  
TEL 03-3616-1612 FAX 03-3616-1615

会社HP 分析無料ご相談



Cross-sectional analysis of electronic circuit boards